

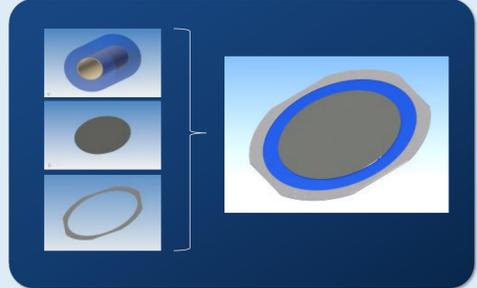
Backend- und AVT-Angebote

200 mm Wafer

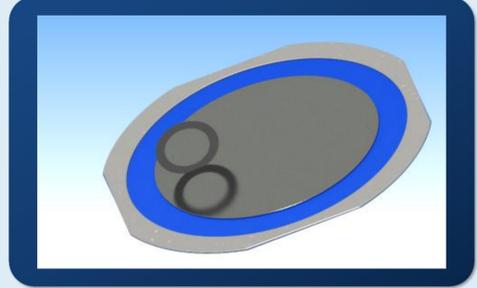
Kontakt: Fritz Herrmann
fritz.herrmann@ipms.fraunhofer.de

+49 351 8823 – 4612;
www.ipms.fraunhofer.de

Laminieren

Nr.	Bezeichnung	
M01	Wafer auf Sägerahmen mit Folie laminieren	
M02	Wafer auf Sägerahmen mit Folie laminieren; Zusätzlich: Schutzfolie auf Vorderseite laminieren	
M03	Vorderseite Wafer belacken	

Trennen

Nr.	Bezeichnung	
D01-Si	Trennen Silizium Wafer < 50 Sägelinien (Dicke < 1 mm; 100 µm Ritzgraben)	
D02-G	Trennen Glas Wafer/Substrat < 50 Sägelinien (Dicke < 0,6 mm; 250 µm Ritzgraben)	
D03-KAV	Kavitäten erzeugen < 50 Sägelinien (Dicke < 1 mm; max. 200 µm Grabentiefe)	

Expandieren / Pick & Place

Nr.	Bezeichnung	
EXP EXP-UV	Expandieren Wafer auf 200 mm Spannring optional mit UV-Belichtung	
P01	Picken Chips vom Wafer in Trays (Waffle Pack o. Gel Pak; komplett o. Auswahl)	
P02	Picken nach kundenspezifischen Vorgaben inkl. Erstellung einer individuellen Picklist	

Bei darüber hinausgehenden Aufgabenstellungen erarbeiten wir gern individuelle Lösungen.